

Модульные моноблоки — новые возможности для вашего бизнеса

Дмитрий Егоров Intel

1

Рынок настольных ПК, перемены грядут....



Прогноз по рынку

AIO TAM Forecast

Source: MS&F Q2'2011 Forecast

	World		Established		Emerging	
	Units	YoY	Units	YoY	Units	YoY
2009	6.4 M	46%	5.6 M	39%	0.8 M	143%
2010	9.8 M	54%	7.4 M	32%	2.5 M	221%
2011	11.9 M	20%	7.3 M	-1%	4.6 M	86%
2012	16.2 M	37%	8.7 M	20%	7.5 M	64%
2013	22.7 M	40%	10.2 M	17%	12.5 M	68%
2014	31.9 M	40%	11.9 M	16%	20.0 M	60%
2015	44.1 M	38%	13.3 M	12%	30.8 M	54%
'10/'15	35%		12%		66%	

- Рыночные прогнозы 66% средний рост на развивающихся рынках, Россия страны СНГ – до 90% рост год к году
- 45% настольных ПК в Китае – моноблоки
- Apple занимает 1/3 мирового рынка моноблоков
- Коммерческий анонс Windows 8 отправная точка массовой

миграции

















- Выбор конфигурации в соответствии с нуждами бизнеса
- Возможность модернизации
- Оперативное восстановление работоспособности



- Экономия рабочего пространства
- Минимум инфраструктурных требований
- Низкий уровень шума и эстетичный внешний вид
- Поддержка сенсорного экрана(опция) + Windows
 8

Модельный ряд конфигурируемых моноблоков





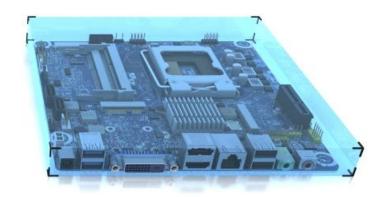
z-размер, видео выход LVDS/eDP, SODIMM память, бортовое питание, поддержка карт расширения Mini PCIe





z-размер, видео выход LVDS/eDP, SODIMM память, бортовое питание, поддержка карт расширения Mini PCIe





z-размер, видео выход LVDS/eDP, SODIMM память, бортовое питание, поддержка карт расширения Mini PCIe



Regular Mini-ITX I/O Shield: 44mm



Thin Mini-ITX I/O Shield: 25mm



z-размер, видео выход LVDS/eDP, SODIMM память, бортовое питание, поддержка карт расширения Mini PCIe





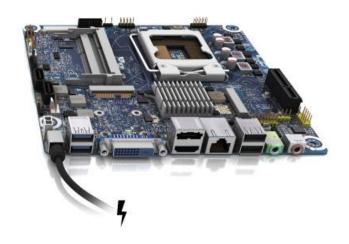
z-размер, видео выход LVDS/eDP, SODIMM память, бортовое питание, поддержка карт расширения Mini PCIe





z-размер, видео выход LVDS/eDP, SODIMM память, бортовое питание, поддержка карт расширения Mini PCIe





z-размер, видео выход LVDS/eDP, SODIMM память, бортовое питание, поддержка карт расширения Mini PCIe





z-размер, видео выход LVDS/eDP, SODIMM память, бортовое питание, поддержка карт расширения Mini PCIe





Поддержка стандарта Mini PCIe









Тепловые пакеты процессоров для настольных ПК (LGA1155)

Pro	cessor	TDP	Timing	
core i5	Core i5-2400S	65W	Доступен	
(intel) inside CORE i3	Core i3-2100T	35W	Доступен	
Pentium inside	Pentium G620T	35W	Q2'11	

На сегодня доступно11 моделей процессоров



Ключевые особенности процессоров Intel® Core™ 3го поколения



- 22нм техпроцесс и трехмерные транзисторы
- Intel® HD Graphics нового поколения с поддержкой DirectX 11
- Встроенные технологии обеспечения безопасности

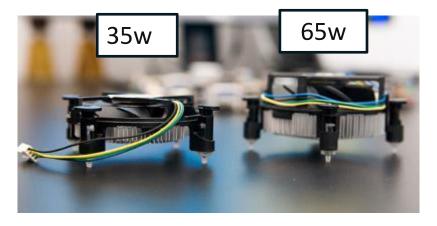




Новый низкопрофильный радиатор в стандартной комплектации ВОХ



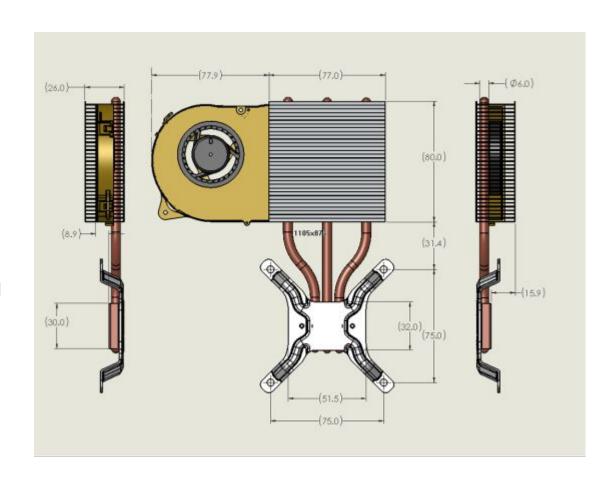
New Boxed 35W Heat Sink Design:





Система охлаждения

- •Предназначена для теплового пакета 65W
- •Возможна поддержка пакета 95W но с более высоким уровнем издаваемого шума
- •Размер в профиль: 19мм









































Базовый

Средний

Производительный







Базовый



Производительный









Базовый





Средний





Производительный





Базовый





Средний





Производительный







Компактный размер, «не петская» произволительносты!





Понятные вещи меняют мир к лучшему





Заинтересовались? Получите больше информации здесь:



